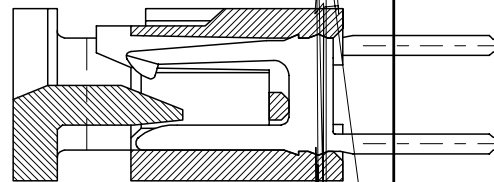


(Γ=C) 挿入深さ

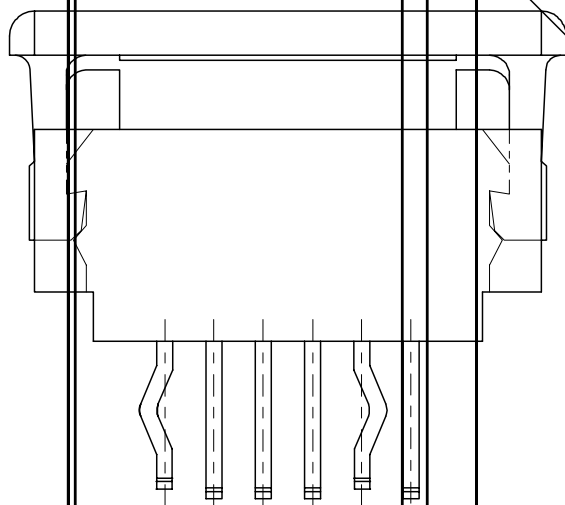
(波高/幅)



(外間隔)

↑ 抜き方向は導へ側から初強板側を推奨致します。
初強フィルム材質は、ポリミールを推奨致します。
↓ 抜き方向は、機械化波高剤を推奨致します。

ABOUT ΓPC:
RECOMMENDED PUNCH PATTERN ON FORM CONDUCTOR
SIDE OF GENERAL BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL:
SOLDER FILM: POLYMER
BONDING AGENT: EPOXY BONDING AGENT



(ピッチ)

(ピッチ)

0.5

(波高/幅)

(ピッチ)

(外間隔)

(り厚さ: 0.3)

適合Γ=C推奨シム

(マウン-由)

MA PATTERN NO.
MODEL NO. 52030 29

注記:

C/ . NO. 1をハサミに偶数番口のソルダノール。

C/ . NO. 1をハサミに奇数番口のソルダノール。

材質:

タミール: シン銅、ツクリ、錫ヒスマスメツ (L 0.32)
EPMAL: P OSP OF EPONZE, N B SML OVER N C CL PL N (0.32)

ハウジング: 66/イロン, UL94V 0

アクア: タ: パリ スル, UL94V 0

4. 本製品は52030 10の鉛フリー品である。
S PPRODUC S LEAD FREE OF 52030 0.